

证券代码：688820

证券简称：盛合晶微

公告编号：2026-018

盛合晶微半导体有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2026年3月3日出具的《关于同意盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕373号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,546.6162万股，发行价格为人民币19.68元/股，本次募集资金总额为人民币5,027,574,068.16元，扣除发行费用人民币248,973,009.21元（含增值税），实际募集资金净额为人民币4,778,601,058.95元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2026年4月15日出具《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0052号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，募集资金专项账户共用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出为人民币418,459.18万元。截至2026年6月30日，公司累计用于募投项目支出为人民币418,459.18万元，募集资金余额为人民币479,626.41万元。具体明

细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 4 月 15 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额（注 1）
一、募集资金总额	502,757.41
减：发行费用	24,897.30
二、募集资金净额	477,860.11
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额（注 2）	418,459.18
加：	
已完成置换审议尚未转出的预先投入募投项目的自筹资金（注 3）	417,860.11
已完成置换审议尚未转出的以自筹资金支付的发行费用（注 3）	2,043.20
尚未支付的发行费用	255.00
募集资金利息收入及扣减手续费等净额	67.17
三、报告期期末募集资金余额	479,626.41

注 1：数据如有尾差系四舍五入所致，下同。

注2：其中包括（1）公司以自筹资金预先投入募投项目金额人民币417,860.11万元；（2）2026年1-6月募集资金专户直接支付的募投项目资金人民币599.07万元。

注3：公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过募集资金置换相关议案，详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-009）。截至2026年6月30日，前述资金尚未从募集资金专户转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度与执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合

公司实际情况，制定了《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。报告期内，公司不存在违反相关法规文件的规定以及公司管理制度的情况。

（二）募集资金三方监管情况

公司、全资子公司盛合晶微半导体（江阴）有限公司分别于 2026 年 3 月、2026 年 6 月与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026 年 4 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
盛合晶微半导体有限公司（SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION）	中国建设银行股份有限公司江阴支行	NRA32050161613609688820	2,325.07	使用中
盛合晶微半导体（江阴）有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161613600004079	477,301.35	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币419,903.31万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，拟使用募集资金人民币417,860.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金，拟使用募集资金人民币2,043.20万元置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2026年6月30日，前述资金尚未从募集资金专户转出。

公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司尚未实施募集资金等额置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司未超募，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

由于公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额低于《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额，公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行募集资金净额的实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	募集资金投资项目	总投资额	调整前拟使用 募集资金投入 金额	调整后拟使用 募集资金投入 金额
1	三维多芯片集成封装项目	840,000.00	400,000.00	398,216.75
2	超高密度互联三维多芯片 集成封装项目	300,000.00	80,000.00	79,643.35
合 计		1,140,000.00	480,000.00	477,860.11

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2026 年 4 月 15 日										
本年度投入募集资金总额			418,459.18										
已累计投入募集资金总额			418,459.18										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
三维多芯片集成封装项目	生产建设	否	400,000.00	398,216.75	398,216.75	338,815.83	338,815.83	-59,400.92	85.08	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
超高密度互联三维多芯片集成封装项目	生产建设	否	80,000.00	79,643.35	79,643.35	79,643.35	79,643.35	0.00	100.00	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			480,000.00	477,860.11	477,860.11	418,459.18	418,459.18	-59,400.92	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括（1）公司以自筹资金预先投入募投项目金额人民币 417,860.11 万元；（2）2026 年 1-6 月募集资金专户直接支付的募投项目资金人民币 599.07 万元。

注 2：三维多芯片集成封装项目已经基本完成项目规划产能建设，由于部分货款尚未到达付款时点，导致报告期末募集资金累计投入进度未达到 100%。

注 3：超高密度互联三维多芯片集成封装项目的募集资金已经使用完毕，后续总投资额超出募集资金的部分将通过自筹资金支付。